

本品採用熱壓封口法測定塑膠薄膜基材、軟包裝複合膜、塗布紙及其它熱封複合膜的熱封溫度、熱封時間、熱封壓力等參數。熔點、熱穩定性、流動性及厚度不同的熱封材料，會表現出不同的熱封性能，其封口工藝參數可能差別很大。HST-H3 熱封試驗儀，通過其標準化的設計、規範化的操作，可獲得精確的熱封試驗指標。

### 特 徵

微電腦控制、液晶顯示  
功能表式介面、PVC 操作面板  
數字 P.I.D.溫度控制  
下置式雙氣缸同步回路  
手動與腳踏二種試驗啟動模式  
上下熱封頭獨立控溫  
可定制多種熱封面形式  
鋁灌封均溫加熱管  
快拔插式加熱管電源接頭  
防燙傷安全設計  
RS232 介面

### 技術指標

熱封溫度：室溫~300℃  
控溫精度：±0.2℃  
熱封時間：0.1~999.9s  
熱封壓力：0.05 MPa~0.7MPa  
熱封面：330mm×10mm（可定制）  
熱封加熱形式：單加熱或雙加熱  
氣源壓力：0.05 MPa~0.7MPa（氣源用戶自備）  
氣源介面：Φ6mm 聚氨酯管  
外形尺寸：536 mm (L)×335 mm (B)×413 mm (H)  
電 源：AC 220V 50Hz  
淨 重：43kg

### 標 準

QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003

### 配 置

標準配置：主機、腳踏開關  
選購件：專業軟體、通信電纜、微型印表機、專用列印線  
注：本機氣源介面系Φ6mm 聚氨酯管；氣源用戶自備。

